VEBKO ONLINE-HILFE

Montagestufen des AMR-Relais

Kategorie	**relay**
Abschnitt	**Einführendes Unternehmen und Producte**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbereitung der Platte “MidPlate” 2
2. Vorbereitung der Netzteilplatine 3
3. Vorbereitung der „CPU“-Karte oder „Hauptkarte“ 3
4. Vorbereitung der „PT-BO-Karte“ 4
5. Vorbereitung der „CT-BI-Karte“ 4
6. Vorbereitung der Frontplatte 5

Das metallische Hauptgehäuse des Relais „AMR“ wurde von Experten der Firma Vebko aus Aluminium3105 entworfen und verschiedene Relaismodule sind in den integrierten Racks untergebracht. Um die Montage zu beginnen, wird die Frontplatte vom Hauptgehäuse geöffnet.



Abbildung 1

1 Vorbereitung der Platte “MidPlate”

Zur Vorbereitung der „MidPlate“ wird das Mikromodul aufgesetzt und die Frontplatte von „Mid Case“, die zuvor geöffnet wurde, auf das Modul „MidPlate“ gelegt und die Schrauben angezogen. Danach wird die Frontplatte zusammen mit „MidPlate“ das Modul „Main Case“ gesetzt und die Schrauben angezogen.



Abbildung 2

2 Vorbereitung der Netzteilplatine

Die Rückseite der „PS“ oder Netzteilkarte wird auf „PS“ Karte platziert und seine Schrauben sind angezogen. Dann wird die „PS“-Karte in das Hauptgehäuse gelegt und die zugehörigen Schrauben angezogen.

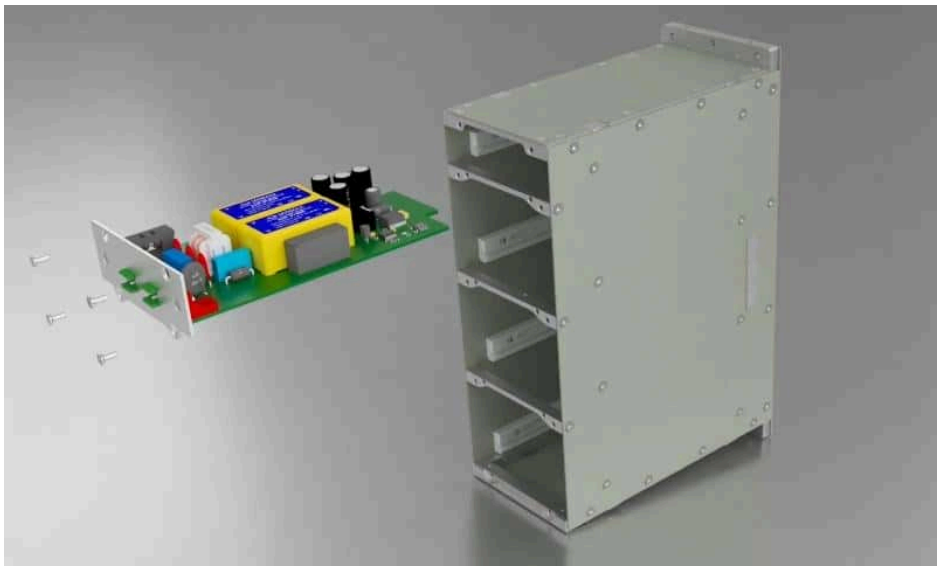


Abbildung 3

3 Vorbereitung der „CPU“-Karte oder „Hauptkarte“

Das Modul „MSD“ wird zusammen mit dem zugehörigen Abstandshalter auf das Mikromodul gelegt und seine Schrauben werden von unten angezogen. Das mikromodul wird auf „Hauptkarte“ als Haupt „CPU“ platziert. Dann wird das Modul „LAN-WiFi“ an der entsprechenden Stelle auf der „Hauptkarte“ platziert und mit 2 Schrauben und Federscheibe von unten angezogen. Außerdem wird das Modul „GPS-RS485“ auf den beiden Abstandshaltern an der Spitze des Moduls „LAN-WiFi“ platziert und mit 2 Schrauben und Federscheibe angezogen und dann, über eine Kommunikationsebene, Modul „GPS“ mit „Hauptkarte“ verbunden. Als nächstes wird „Rückseite“ der "Main Card" auf der Karte platziert und mit den zugehörigen Schrauben zusammen mit 4 Abstandshaltern an der „GPS-Antenne“ des „Rückseite“ befestigt. Schließlich wird die „Hauptkarte“ in das Gehäuse gelegt und die Schrauben angezogen.



Abbildung 4

4 Vorbereitung der „PT-BO-Karte“

Um diese Karte vorzubereiten, wird das Modul „AD gain“ an der entsprechenden Stelle auf der „PT-BO-Karte“ platziert und mit Schrauben und Federscheibe von unten angezogen. Dann werden vier Module „PT“ an ihren jeweiligen Platz auf der „PT-BO-Karte“ platziert und ihre Schrauben und Federscheibe werden von unten angezogen. Gegenwärtig wird das BO-Modul (Binary Output) auf 41 Millimeter Abstandshaltern platziert und seine Schrauben und Federscheiben sind angezogen. Dann wird die Kommunikationsebene zwischen „BO“ und „PT-BO“ angeschlossen. Danach wird die Rückseite der „PT-BO-Karte“ mit 4 Schrauben an die „PT-BO-Karte“ angeschlossen und dann wird diese Karte an ihrer vorgesehenen Stelle im Gehäuse platziert und dann werden die Schrauben angezogen.

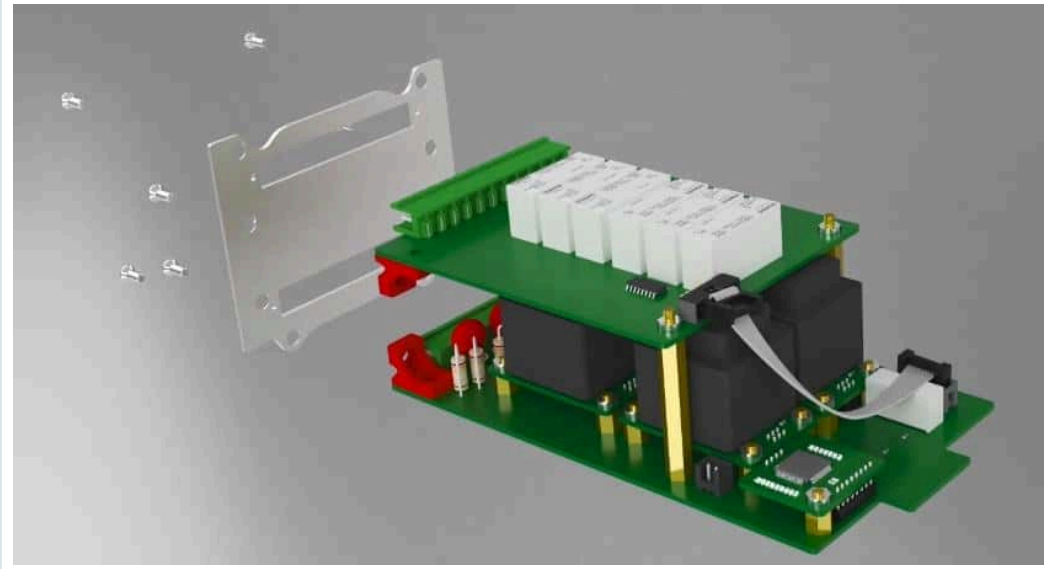


Abbildung 5

5 Vorbereitung der „CT-BI-Karte“

Zur Vorbereitung dieser Karte wird der Barrierestecker an das „Rückseite“ der „CT-BI-Karte“ angeschlossen und dieses „Rückseite“ mit der „CT-BI-Karte“ verbunden. In diesem Stadium wird das Modul „AD Gain“ auf der „CT-BI-Karte“ platziert und mit Schrauben und Federscheibe angezogen. Jetzt werden vier Module „CT“ auf der „CT-BI-Karte“ platziert und schrauben und Federscheibe angezogen. Dann wird ein 2,5-Strangdraht durch „CT“ geleitet und nach dem Schwingen an den Schrankenstecker gelötet. Dann werden die Verbindungen mit Lack (oder Scheren) abgedeckt. In dieser Phase wird das Modul „BI“ (Binary Input) auf 43-Millimeter-Abstandshaltern und seinen 3 Schrauben und

Federscheiben platziert und die Schrauben der Rückseite sind angezogen. Als nächstes ist die Kommunikationswohnung mit der „CT-BI-Karte“ verbunden. Schließlich wird die „CT-BI-Karte“ an ihrem integrierten Platz im Gehäuse platziert und die 4 Schrauben angezogen.

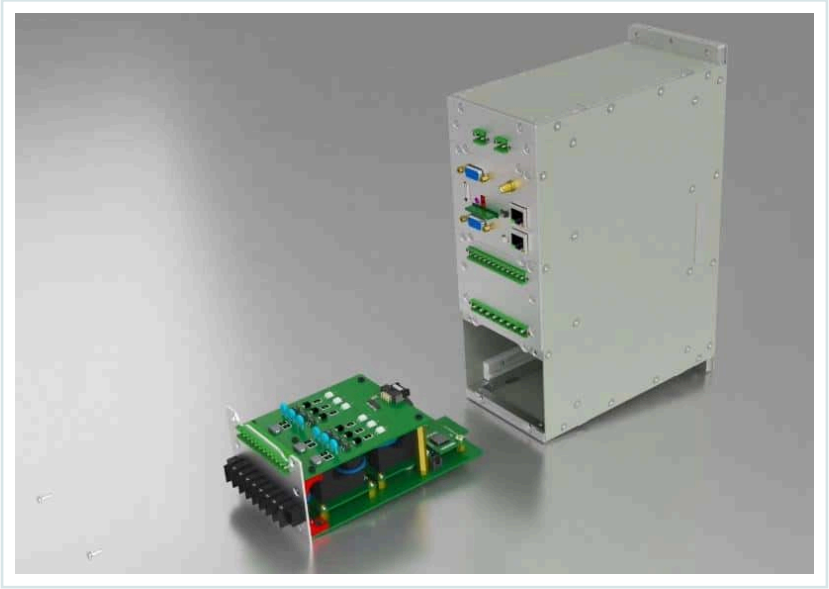


Abbildung 6

6 Vorbereitung der Frontplatte

Der erste Schritt bei der Vorbereitung von „Frontplatte“ ist das Öffnen der Rückseite von „LCD-CASE“. Dann wird das Modul „LAN“ auf das Modul „Frontplatten“ gesetzt und seine Schraube und Federscheibe angezogen. Als nächstes wird das Modul „MSD“ zusammen mit dem zugehörigen Abstandshalter auf das Mikromodul gesetzt und seine Schrauben von unten angezogen. Am Ende wird das Mikromodul auf der „Frontplatte“ platziert.

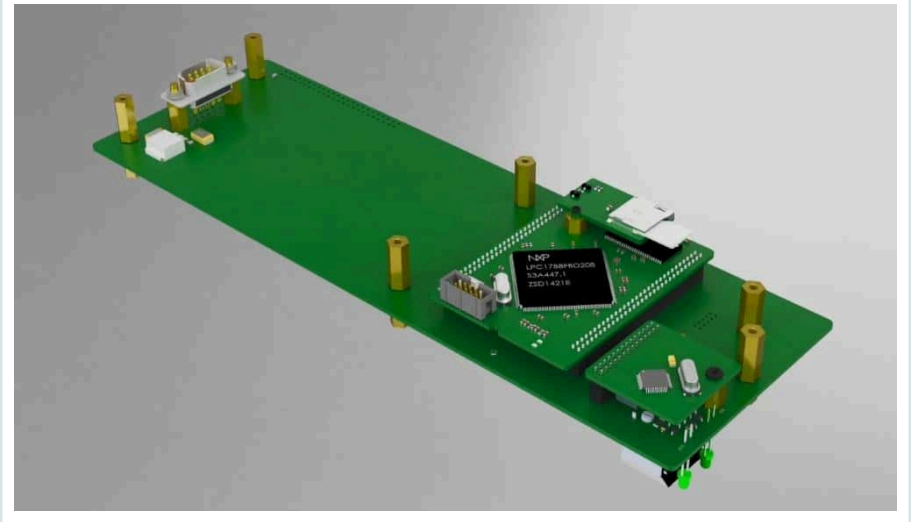


Abbildung 7

Nach dem Schließen der Rückseite von „LCD-CASE“ auf der Rückseite von „Frontplatte“ wird das Modul „RS232“ auf „Frontplatte“ platziert und die 3 Schrauben und die Federscheibe werden angezogen. Zuletzt wird „LCD“ auf das Modul „LCD“ gelegt und die zugehörige Fläche angeschlossen, dann wird das Modul „LCD“ auf „Frontplatte“ platziert und seine 4 Schrauben und die Federscheibe angezogen. Nach der Vorbereitung der „Frontplatte“ Platine wird es im Hauptgehäuse von „LCD-CASE“ platziert und seine Schrauben werden an der Rückseite angezogen.

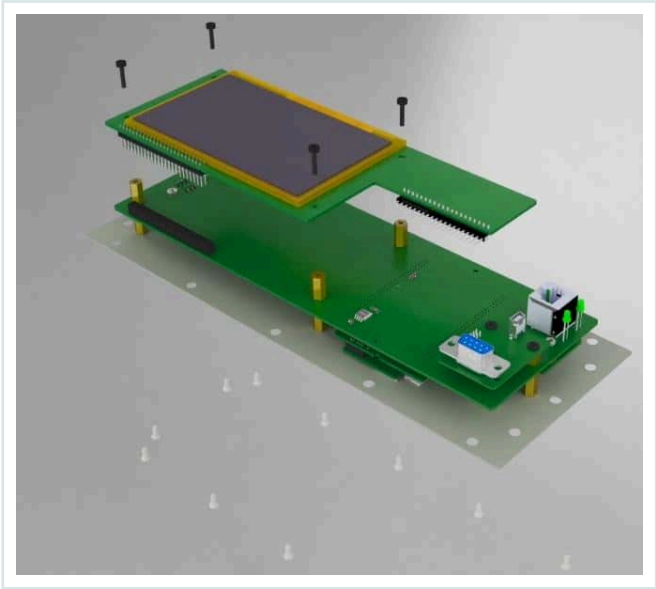


Abbildung 8

In der letzten Phase wird die Frontplatte des „LCD-CASE“ geöffnet und ein Etikett darauf geklebt. Dann wird das flache Etikett mit dem entsprechenden Stiftkopf auf dem Modul „LCD“ verbunden und die Platte wird an der vorgesehenen Stelle platziert und ihre Schrauben angezogen. Beachten Sie, dass sich auf der „Frontplatte“ zwei Abstandshalter befinden und die „Frontplatte“ mit zwei 4*50 Schrauben mit dem Relais-Hauptgehäuse verbunden ist.



Abbildung 9

[jg1]RE_Assembly_Stages_of_AMR_Relay